

苏州锴威特半导体股份有限公司董事会
关于本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的重组上市情形的说明

苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买晶艺半导体有限公司（以下简称“晶艺半导体”或“标的公司”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，晶艺半导体将成为上市公司的全资子公司。

公司作为本次交易的收购方，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）第十二条规定的重大资产重组，但不构成第十三条规定的重组上市，具体如下：

一、本次交易预计构成重大资产重组

截至本说明出具之日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定。根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，本次交易预计将构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告中予以详细分析和披露。

本次交易的正式交易方案尚需经公司董事会和股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

二、本次交易不构成重组上市

本次交易前后，上市公司控股股东、实际控制人均为丁国华，本次交易不会导致上市公司控制权变更，根据《重组管理办法》第十三条的规定，本次交易不构成重组上市。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《苏州锴威特半导体股份有限公司董事会关于本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的重组上市情形的说明》之盖章页）

苏州锴威特半导体股份有限公司董事会

2026年3月28日